

证券代码：688809

证券简称：强一股份

公告编号：2026-060

**强一半导体（苏州）股份有限公司**  
**关于公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的**  
**公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）的担保额度。
- 公司及公司合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。

**● 担保对象及基本情况**

| 被担保人名称        | 本次担保金额       | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内    | 本次担保是否有反担保 |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------|------------|
| 强一半导体（南通）有限公司 | 25,000.00 万元 | 0.00 万元               | 不适用：本次为担保额度预计 | 否          |
| 强一半导体（合肥）有限公司 | 50,000.00 万元 | 0.00 万元               | 不适用：本次为担保额度预计 | 否          |

**● 累计担保情况**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元）             | 0              |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 0（不包含本次担保额度预计） |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 0              |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特别风险提示（如有请勾选） | <input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%<br><input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%<br><input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有）    | 无                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 一、申请综合授信额度及提供担保情况概述

### （一）申请综合授信额度情况概述

为了提高公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）融资的便利性，满足业务发展的实际需要，改善现金流状况、降低经营风险、促进经营发展，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 40 亿元的综合授信额度（包括存量、新增和续签），用于办理包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、抵押贷款等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。以上授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以各家银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人士在审批通过的授信额度内决定融资的相关事宜并签署相关法律文件。前述授信额度及授权事项的有效期为自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授信额度在有效期内可由公司及子公司（含授权期限内新设立的子公司或新增收购的子公司）滚动使用。

### （二）提供担保情况概述

为满足经营和业务发展的资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证等。本次担保预计不存在反担保。

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及子公司与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人士根据公司实际经营情况需要，在上述担保额度范围内办理相关手续，包括但不限于签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述担保额度及担保事项的有效期为自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内由相关子公司循环使用。

### （三）内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 28 日分别召开第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》。该事项尚需提交股东会审议。

### （四）担保预计基本情况

| 担保方              | 被担保方          | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期                        | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|------------------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 一、对全资子公司         |               |         |               |              |              |                    |                                |        |        |
| 被担保方资产负债率超过 70%  |               |         |               |              |              |                    |                                |        |        |
| 公司及子公司           | 强一半导体（南通）有限公司 | 100%    | 85.27%        | 0.00         | 25,000.00    | 6.01%              | 自股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止 | 否      | 否      |
| 二、对全资子公司         |               |         |               |              |              |                    |                                |        |        |
| 被担保方资产负债率未超过 70% |               |         |               |              |              |                    |                                |        |        |
| 公司及子公司           | 强一半导体（合肥）有限公司 | 100%    | 39.75%        | 0.00         | 50,000.00    | 12.01%             | 自股东大会审议通过之日起                   | 否      | 否      |

|    |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| 公司 |  |  |  |  |  |  | 通过之日至2026年度股东大会召开之日 |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

#### （五）担保额度调剂情况

上表为公司及子公司预计向合并报表范围内的子公司提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资及担保的金额。

为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的控股子公司或新增收购的控股子公司）的实际业务发展需要，在预计担保额度内互相调剂使用。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）基本情况

##### 1、强一半导体（南通）有限公司

|                 |                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被担保人类型          | 法人                                                                                                                                  |
| 被担保人名称          | 强一半导体（南通）有限公司                                                                                                                       |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司                                                                                                                               |
| 主要股东及持股比例       | 公司直接持股 100%                                                                                                                         |
| 法定代表人           | 周明                                                                                                                                  |
| 统一社会信用代码        | 91320693MACDTBBN78                                                                                                                  |
| 成立时间            | 2023 年 4 月 12 日                                                                                                                     |
| 注册地             | 江苏省南通市苏锡通科技产业园区海宾路 10 号                                                                                                             |
| 注册资本            | 35,000 万元人民币                                                                                                                        |
| 公司类型            | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                                                                              |
| 经营范围            | 一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属材料制造；金属材料销售；电力电子元器件制造；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

|            | 项目   | 2026年6月30日/2026年1-6月（经审计） | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
|------------|------|---------------------------|-------------------------|
| 主要财务指标（万元） | 资产总额 | 142,861.59                | 139,206.72              |
|            | 负债总额 | 121,816.42                | 121,321.98              |
|            | 资产净额 | 21,045.17                 | 17,884.74               |
|            | 营业收入 | 0.00                      | 0.00                    |
|            | 净利润  | -39.57                    | -242.30                 |

## 2、强一半导体（合肥）有限公司

|                 |                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 被担保人类型          | 法人                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |
| 被担保人名称          | 强一半导体（合肥）有限公司                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |
| 主要股东及持股比例       | 公司直接持股 100%                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |
| 法定代表人           | 周明                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |
| 统一社会信用代码        | 91340111MA8P07EY0C                                                                                                                                                                                             |                           |                         |
| 成立时间            | 2022年4月29日                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |
| 注册地             | 安徽省合肥市经济技术开发区青龙潭路集成电路科技园C3栋一层北区和二层北区                                                                                                                                                                           |                           |                         |
| 注册资本            | 40,500 万元人民币                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |
| 公司类型            | 有限责任公司（外商投资企业法人独资）                                                                                                                                                                                             |                           |                         |
| 经营范围            | 一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；光电子器件制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料制造；特种陶瓷制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |                           |                         |
| 主要财务指标（万元）      | 项目                                                                                                                                                                                                             | 2026年6月30日/2026年1-6月（经审计） | 2025年12月31日/2025年度（经审计） |
|                 | 资产总额                                                                                                                                                                                                           | 27,246.28                 | 23,183.57               |
|                 | 负债总额                                                                                                                                                                                                           | 10,831.49                 | 6,962.26                |
|                 | 资产净额                                                                                                                                                                                                           | 16,414.78                 | 16,221.31               |
|                 | 营业收入                                                                                                                                                                                                           | 3,408.77                  | 5,409.60                |
|                 | 净利润                                                                                                                                                                                                            | -806.52                   | -1,406.37               |

## （二）被担保人失信情况

经查询，截至本公告披露日，以上被担保方均不属于失信被执行人。

### **三、担保协议的主要内容**

公司及子公司目前尚未签订具体担保协议。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及子公司与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项系为确保公司及子公司日常经营稳健发展需要，符合公司整体利益和发展战略规划，有利于公司长远发展，具有必要性。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司能及时掌握其资信情况、履约能力，且担保资金用途为日常资金使用及业务需求，担保风险可控。本次担保事项不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **五、董事会意见**

公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度，以及公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司日常经营的资金需要。担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

### **六、审计委员会意见**

本次公司及子公司申请综合授信额度，以及公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保事项符合公司及子公司的实际经营和整体发展战略，有利于其稳健经营和长远发展，对公司持续经营能力、资产状况无不良影响，符合公司整体利益和发展战略，公司对被担保方经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险总体可控。

综上，审计委员会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 七、保荐人意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司及子公司本次向子公司提供担保事项是基于子公司日常经营及业务发展资金需要，符合上市公司利益，该事项已经公司董事会审议通过，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定，未损害公司及股东的利益。

综上，保荐人对本次公司及子公司向子公司提供担保额度预计事项无异议。

## 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司均不存在对外担保的情况。

公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日